证券代码：300656　　证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-011

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　☐业绩说明会 □新闻发布会　☐路演活动 □现场参观　☑其他：电话会议
参与单位名称	东方嘉富、财通基金、华夏基金、国泰基金、兴全基金、泉果基金、南方基金、金鹰基金、东海基金、高林基金、中庚基金、永赢基金、富国基金、国元创新投、浙江发展资产公司、常州金融投资集团、明善资本、中大君悦投资、朗姿韩亚资管、华安资管、瑞华投控、华泰资产、中国国际金融资管、涌乐投资、中和资本、宽裕资本、珠池资产、自盟投资、国信证券、国联民生证券、中信证券、中泰证券、长城证券
时间	2026 年 11 月 6 日-11 月 16 日
地点	浙江丽水，广芯微电子会议室；武汉，上海；线上会议
上市公司接待人员姓名	广芯微电子总经理：谢刚 董事：高健 IR 总监：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	**1、晶圆代工厂一期 10 万片/月产能达产进度情况？** **答：**广芯微电子今年二季度以来，通过股权融资、银行固定资产贷款等方式筹集资金，用于项目扩产。截至目前，广芯微电子已与多家设备供应商签署采购协议，其中扩产至 6 万片/月所需设备已分批陆续到厂并进入调试阶段，扩产至 10 万片/月所需设备，多数也已签署采购协议，广芯微电子产能预计会在今年四季度开始逐步释放。按照目前晶圆代工厂的扩产计划，定增资金到位后设备会加快进场，预计明年下半年达到 10 万片的月产能。 **2、公司 2026 年及 2027 年整体业务发展情况如何？** **答：**（1）功率半导体业务：2026 年前三季度，功率半导体业务营业收入同比增长 339.29%，占上市公司整体收入比重也明显提升；2026 年全年，预计功率半导体业务营业收入同比会有大幅度增长。其中，晶圆代工厂广芯微电子，随着产能的提升，2026 年

	前三季度收入较上年同期大幅增长，且合并范围外的设计公司客户销售额占比逐步增加；功率半导体设计公司广微集成，核心产品 MFER 销售逐渐恢复，产品出货量同比大幅提升。（2）AiDC 业务：2026 年前三季度实现营业收入 9,660.19 万元，剔除去年同期君安技术公司收入后，同比减少 26.12%，受上游存储等原材料价格大幅上涨影响，今年年初，公司对 AiDC 产品物料清单进行了优化调整，部分海外客户需对产品重新验证，对前三季度收入造成阶段性影响；目前海外客户验证工作已完成，自 9 月起已恢复批量出货。公司 AiDC 业务未来仍保持相对稳健发展，维持较好的毛利率水平，为公司持续贡献稳定经营性现金流。（3）电子元器件分销业务：受益于电子元器件市场景气度高，公司分销业务 2026 年前三季度实现营业收入 5,313.84 万元，同比增长 141.34%。2026 年全年，公司电子元器件分销业务营业收入预计同比会有较大幅度增长。 经过几年的产能建设，公司功率半导体业务已具备坚实的基础，目前订单饱满。2027 年，伴随着晶圆代工厂产能的不断提升，公司功率半导体业务的收入将会逐季增长，上市公司整体的经营情况也将会不断向好。 **3、公司扩建 6 英寸晶圆代工产线，其优势和市场竞争力在哪里？** 答：公司扩建 6 英寸高压、大功率晶圆代工产线，主要有以下几方面原因： 第一，市场响应与成本。功率半导体行业普遍具有“小批量、多品种、定制化”的典型特征，特别是 IGBT 等高压、大功率产品，其应用导向性极强，与终端系统深度耦合，对定制化工艺调优及参数匹配的依赖性极高。相较于大尺寸晶圆产线，6 英寸产线在应对多样化、快速迭代的产品需求时，具备天然的生产柔性与经济性优势，能够以更低的生产成本、更快的研发转化速度，响应客户在中高压、特种应用场景下的定制化需求。 第二，性能与可靠性。高压、大功率器件对产品稳定性、可靠性等要求极高，这些产品都需要经过深沟槽、高温注入等环节，6 英寸相较 8 英寸和 12 英寸产品，本身的物理结构更稳固，翘曲度更低，更适合于高压、大功率器件的生产，在高压、大功率赛道，反倒更适合用 6 英寸产线来做。 第三，广芯微电子的设备配置在国内 6 英寸功率半导体晶圆厂中具备较强的制造水平，已拥有深沟槽刻蚀工艺等多项核心技术工艺，700V 高压 BCD 工艺平台也已建成，工艺平台能力属业内较高端的平台，产品线丰富，在高压、特高压领域具有一定的优势。 在大功率供电系统、特高压电网、新能源储能变流器等应用场景中，对功率半导体

	的可靠性要求极为严苛，而由于结构差异，基于高端 6 英寸工艺平台的高压/特高压、大功率半导体往往能更好地满足上述需求，特别是在面向对功率半导体可靠性要求极为严苛的 AI 数据中心、新型能源革命等相关市场中，高端 6 英寸特色工艺平台及基于其设计的高压、大功率半导体产品具备更强的适配性，生产需求也显著攀升。 因此，广芯微电子晶圆代工业务专注于特色功率半导体晶圆代工业务，聚焦高压、大功率半导体的研发与生产。公司本次定增中 7 亿元将用于 6 英寸特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工项目，达产后，预计将新增适用于高压、大功率领域的特高压 VDMOS、IGBT 和 700V 高压 BCD 等产品的晶圆代工产能 6 万片/月。 **4、6 英寸功率半导体晶圆代工市场情况如何？** **答：**从去年下半年开始，由于 AI 数据中心、电网升级等领域的带动，市场需求呈现高速增长态势，其中内存涨价 10 倍以上，电容、电阻、二极管、三极管等也都在涨价。受制于晶圆制造的复杂程度，以及出于供应链安全考虑而带来的本土化布局，晶圆代工新增产能会受到制约，需求远大于供给，未来 3~5 年将是晶圆代工行业的景气周期。 需求端，随着 AI 大模型算力呈指数级攀升，大型数据中心用电规模已迈入吉瓦级，供电能力成为制约 AI 规模化落地的核心瓶颈——“AI 的尽头是电力”已成行业共识。每一瓦电能都要经过功率半导体进行转换与分配，GPU 功耗逐代攀升，带动功率芯片用量成倍增长。而这些 MOSFET、IGBT、高压 BCD 等器件恰恰主要在 6、8 英寸成熟制程生产，功率器件对线宽要求不高、但对耐压可靠性要求极高，6 英寸高压工艺反而最匹配、性价比最高。 供给端，台积电、三星等国际巨头正集中资源投向先进制程，扩大 12 英寸产能，同时逐步收缩 6、8 英寸成熟制程产能。在国际巨头主动收缩成熟制程产能的同时，下游需求正迎来结构性复苏。AI 带动的电源管理芯片、功率器件等成熟制程需求呈指数级增长，供需关系趋于紧张。供需失衡的结果是，目前国内 6、8 英寸晶圆代工厂产能利用率接近满产，6 英寸产能正在成为稀缺资产。 综上，6 英寸功率晶圆代工因匹配功率器件工艺特性、叠加巨头让出成熟制程等因素，成为本轮 AI+电力革命中最紧缺的资产之一，预计未来 3-5 年将处于行业景气周期。 **5、广芯微电子已量产产品有哪些，工艺平台有什么特点？** **答：**广芯微电子项目自 2024 年投产以来，完成了包括 MOS 场效应二极管（MFER）、垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管（VDMOS）、瞬态电压抑制二极管（TVS）、

	绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、Bipolar-CMOS-DMOS（BCD）等工艺平台的搭建，其中 MFER、VDMOS 和 TVS 等产品已实现规模化量产，面向工业、能源等领域的特高压电源产品平均良率超 95%，消费类电源及电机驱动产品平均良率达 98%以上；与 IC 合封的 VDMOS 产品已经验证通过，开始量产；IGBT 和 700V 高压 BCD 已处于客户流片及导入阶段，产品的核心工艺环节都已完成验证，现有设备已具备量产能力，整体进展情况良好，预计 2027 年上半年进入量产阶段。 广芯微电子已搭建了国内较为高端的 6 英寸特色工艺平台，其中的深沟槽刻蚀设备、1.2MeV 的高温离子注入机等设备，属于业内顶尖的设备，是国内为数不多的可以生产特高压 VDMOS、700V 高压 BCD 等产品的企业，已量产产品的良率已经做到业界优秀水准。 **风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。**
附件清单（如有）	无
日期	2026-11-17